

現場技術成果展示

單位	項目	技術項目簡介
半導體中心	設計服務	<ul style="list-style-type: none"> • TSRI AI SoC設計平台 • 嵌入式視覺處理器設計平台(EV-CNN) • 物聯網晶片系統設計平台
	前瞻技術應用	<ul style="list-style-type: none"> • iSOMA • PaS • SenCu
	單晶片整合技術	<ul style="list-style-type: none"> • 第五代行動通訊、毫米波PCB天線和IPD天線靜態展示 • 適用於5G系統的毫米波寬頻調變設備與量測技術
	異質整合	<ul style="list-style-type: none"> • 馬達驅動IC晶片系統 • TSRI 投影燈 • 高整合度之3-axis加速度單晶片 • 獵能晶片
	微影光罩 異質整合製程 蝕刻薄膜 蝕刻薄膜	<ul style="list-style-type: none"> • 智慧型寬頻振動器 • 智慧型感測奈米晶片 • 3D IC • GaN綠能功率晶片
儀科中心	常壓電漿系統	常壓電漿表面改質技術可提供物件表面活化處理，進而運用在光學元件表面處理及鍍膜應用上。
	智慧工廠簡介	以TIRI暨有實驗設施做為傳統製程與異質系統整合之情境示範，及學界研發成果導入業界前之驗證測試場域。
國網中心	1.SciDM資料集平台	整合資料聚合、管理、展示等功能，開發結合高速計算可介接之資料處理框架，透過多樣化資料處理工具，提供整合式資料媒合與資訊加值平台。對於資料研究者而言，獲得更快速、更精確、更直覺的方式，讓資料展現其更精粹之價值。
	2.深度學習於淹水深度影像辨識應用	與經濟部水利署合作，結合深度學習與路口監視影像，以車輛為辨識標的，進行道路淹水深度推估之影像辨識，此方法可利用都市內既有的監視系統，快速提升具水災警戒與通報防汛系統。
	3.TWCC臺灣AI雲	TWCC以最新之容器化技術提供服務，透過優化過的AI軟體堆疊，同時支援大量調度節點與GPU，跨節點高速平行運算。除提供快速運算能力、大量儲存空間及安全的網路外，此平台亦將整合國內各界發展之AI程式與工具、以及國內外重要資料集，彙集成為國內最大的模式市集與資料市集，提供產學研界更即時、更便利的運算服務。